

SdK-Unternehmens- präsentation – SUSS MicroTec SE



Das Unternehmen im Überblick





SUSS auf einen Blick



- Hidden Champion mit Hauptsitz in Deutschland und einer 75-jährigen Erfolgsgeschichte in Bezug auf Innovation und Wachstum
- Schlüsselanbieter von Technologien für das Frontend und Advanced Backend der Halbleiterbranche
- Globale Kundenbasis mit > 75% Umsatzanteil in Asien
- Strategischer Partner für weltweit tätige Halbleiterhersteller (IDMs) und Auftragsfertiger (Foundries)
- Innovator mit gut ausgebautem Netzwerk zu renommierten Forschungsinstituten und Universitäten

SUSS ist Teil unseres digitalen Lebens!

Das Unternehmen in Zahlen

8.000
Systeme

Weltweit mehr als
8.000 installierte
Systeme

446,1
in Millionen €

Umsatz im
GJ 2024

423,7
in Millionen €

Auftragseingang im
GJ 2024

~1.500
Mitarbeitende

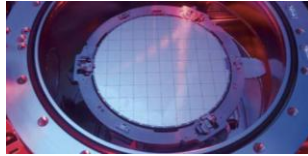
Zum 31.12.2024, davon
59% in EMEA, 36% in
APAC und 5% in
Nordamerika

Meilensteine unserer Unternehmensgeschichte



1949

Gründung der Karl
Süss KG in München



1990

Start der Serien-
produktion von
Wafer-Bondern



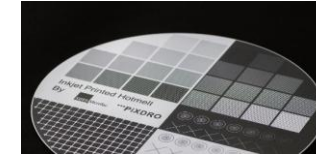
2000

Integration von Be-
schichtungssystemen
durch Akquisition von
Fairchild Technologies



2010

Eröffnung des zweiten
deutschen Standorts
in Sternenfels nach
Übernahme von
Hamatech APE



2020

Aufnahme des Inkjet-
Drucks ins Leistungs-
portfolio durch Über-
nahme von PiXDRO



2024

Relaunch der Marke
als SUSS



1963

Entwicklung des
weltweit ersten Mask-
Aligners SUSS MJB3



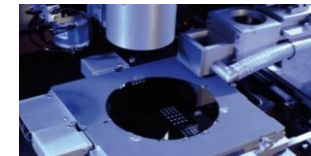
1999

Börsengang an der
Frankfurter Börse



2001

Umbenennung des
Unternehmens in
SÜSS MicroTec



2012

Ergänzung der Laserpro-
zessierungstechnologie
nach Akquisition von
Tamarack Scientific



2020

Eröffnung des asiati-
schen Produktions-
standorts in Hsinchu/
Taiwan



CFO
Dr. Cornelia Ballwießer

- Finanzen und Controlling
- Recht und Compliance
- Risikomanagement
- Investor Relations
- IT
- ESG



CEO
Burkhardt Frick

- Vertrieb und Service
- Strategie
- HR
- Interne Revision
- Business Units:
Advanced Backend Solutions,
Photomask Solutions



COO
Dr. Thomas Rohe

- R&D
- Einkauf
- Produktion
- Logistik
- Qualitätsmanagement
- Produkt-Center
- Facility Management

Unsere zwei Geschäftsbereiche, mit vollem Fokus auf die Halbleiterbranche

Frontend

Advanced Backend

Bereiche Photomask Solutions

Advanced Backend Solutions



Produkte Photomask Equipment



MaskTrack X

Imaging

Mask Aligner
MA200/300



Projection
Scanner
DSC300

Coating



ACS300

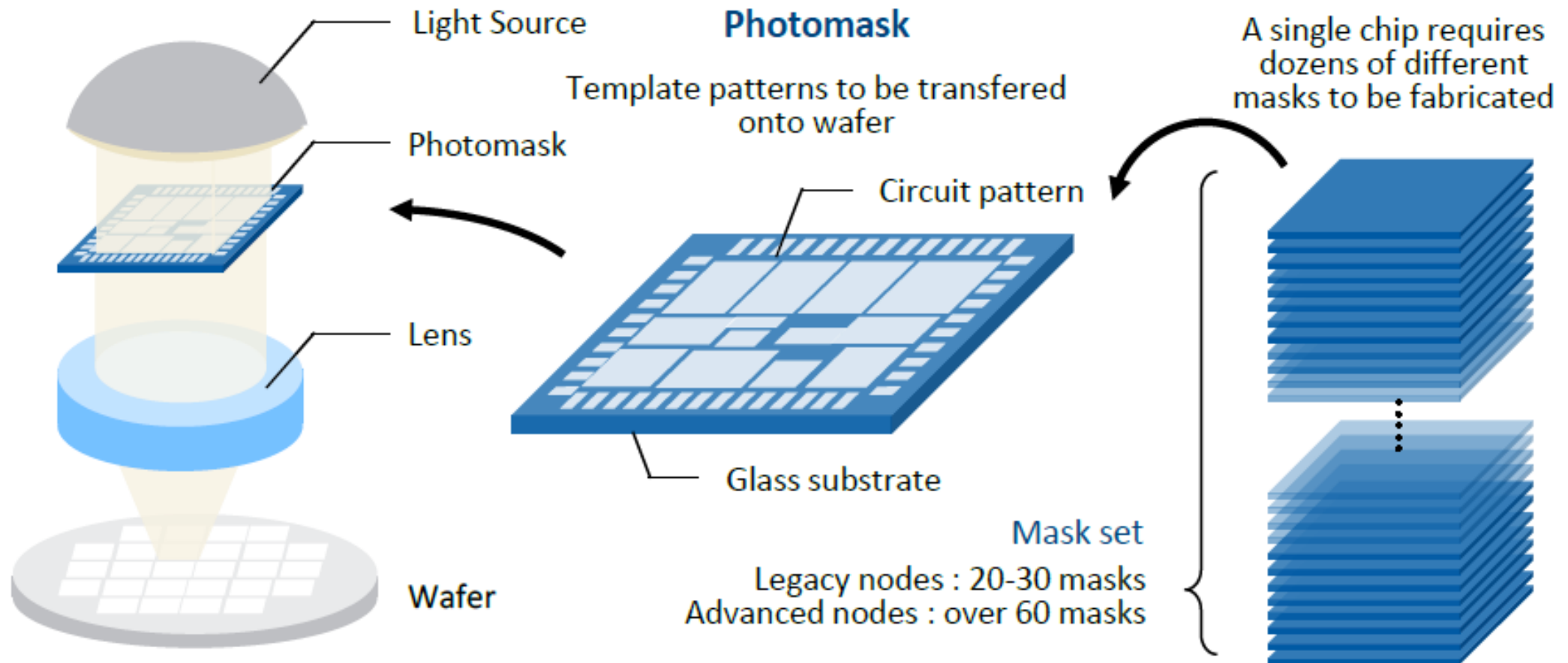
Bonding

XBC300



XB8

Unsere Kernkompetenz liegt darin, lithografische Fotomasken und Wafer zu prozessieren



Source: Morgan Stanley Research

Advanced Backend Solutions Portfolio-Highlights – Imaging Systems



MASK
ALIGNER

MA/BA8 Gen4



PROJEKTIONS-
SCANNER

DSC300 Gen3

Mit über 60 Jahren Innovationserfahrung bietet SUSS erstklassige Belichtungslösungen vom Labor bis zur Großserienproduktion.



MASK
ALIGNER

MA200 Gen3



MASK
ALIGNER

MA300 Gen3

Advanced Backend Solutions Portfolio-Highlights – Coating Systems



BELACKER/
ENTWICKLER

ACS200 Gen3 TE



BELACKER/
ENTWICKLER

ACS300 Gen2

SUSS ermöglicht die Auswahl zwischen Lösungen für Rotationsbeschichtung, Sprühbelackung oder Tintenstrahldruck – ganz nach Anwendungsbedarf.



BELACKER/
ENTWICKLER

ECD8



TINTENSTRAHL-
DRUCKER

JETx



BELACKER/
TINTENSTRAHL-
DRUCKER

ACS200 Gen3 TE -
JETx

Advanced Backend Solutions Portfolio-Highlights – Bonding Systems



PERMANENT-
WAFER-
BONDEN

XBS200



HYBRID-
WAFER-
BONDEN

**XBC300 Gen2
D2W/ W2W**

SUSS ist Marktführer für Temporär-Bond- und Debondlösungen. Anlagen für das Permanent- und Hybridbonden ergänzen das Portfolio.



TEMPORÄR-
WAFER-
DEBONDEN

XBC300 Gen2



TEMPORÄR-
WAFER-
BONDEN

XBS300

Photomask Solutions Portfolio-Highlights



Reinigung
Stripping
Entwicklung

HMx Series



Reinigung
Stripping
Entwicklung
PEB

ASx Series

Wir bieten Fotomaskenlösungen vom Labor bis zur Großserienproduktion – skalierbare Lösungen, die die nächsten Technologieknoten unterstützen können.



Bake
Entwicklung
KI-Analyse

MaskTrack Smart BD



Entfernung
des Pellikel-
klebers

MaskTrack X GB



Reinigung
Stripping
Bake / Ent-
wicklung

MaskTrack PRO / X

Wir sind ein Weltkonzern mit lokaler Präsenz







 (HQ) Deutschland  Standorte  Vertriebspartner






Nordamerika

 USA

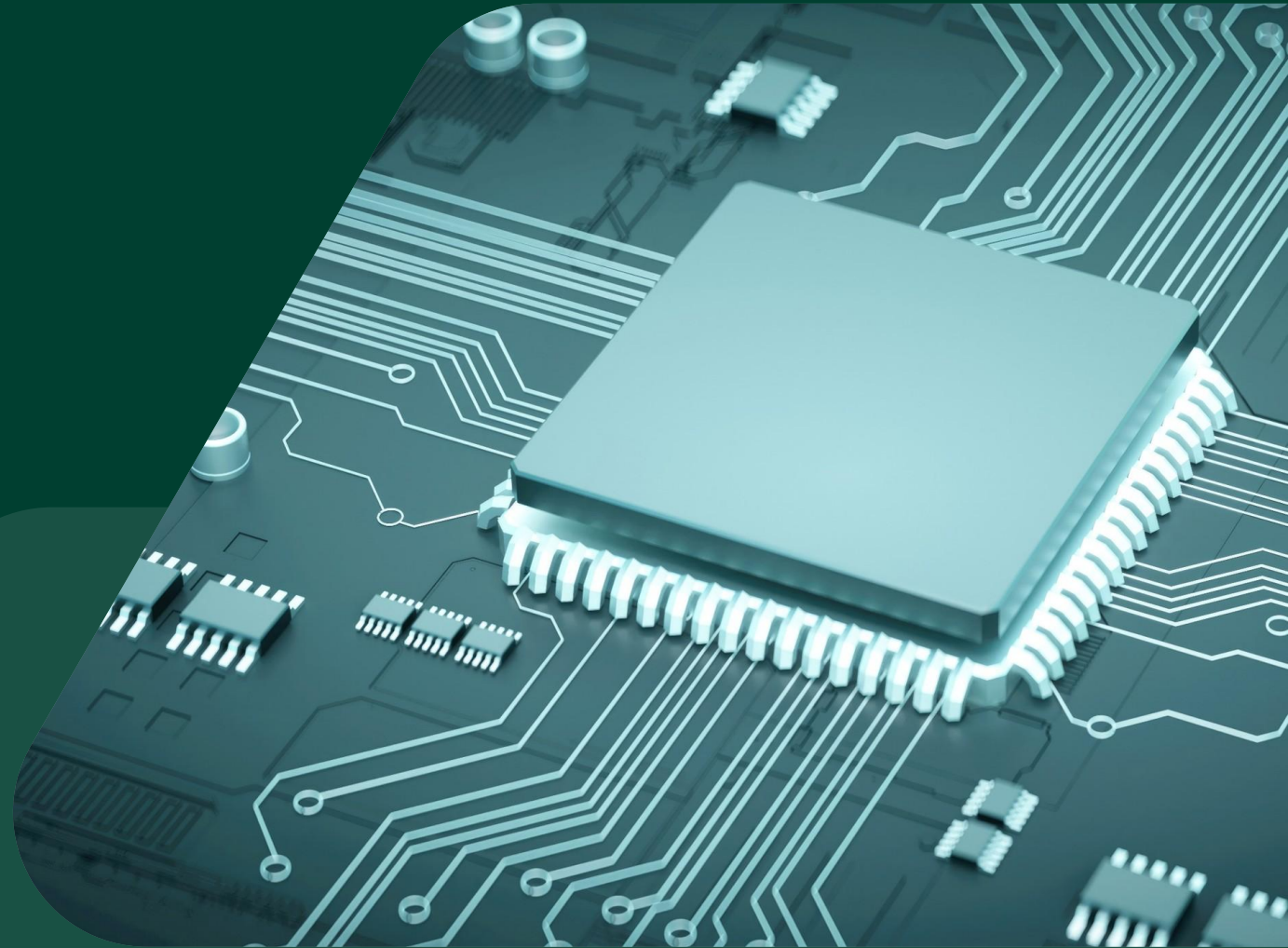
Europa

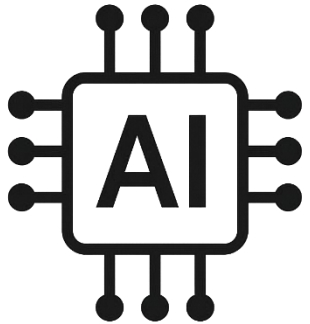
 (HQ) Deutschland
 Vereinigtes Königreich
 Niederlande
 Frankreich

Asien

 Japan
 Korea
 China
 Taiwan
 Singapur

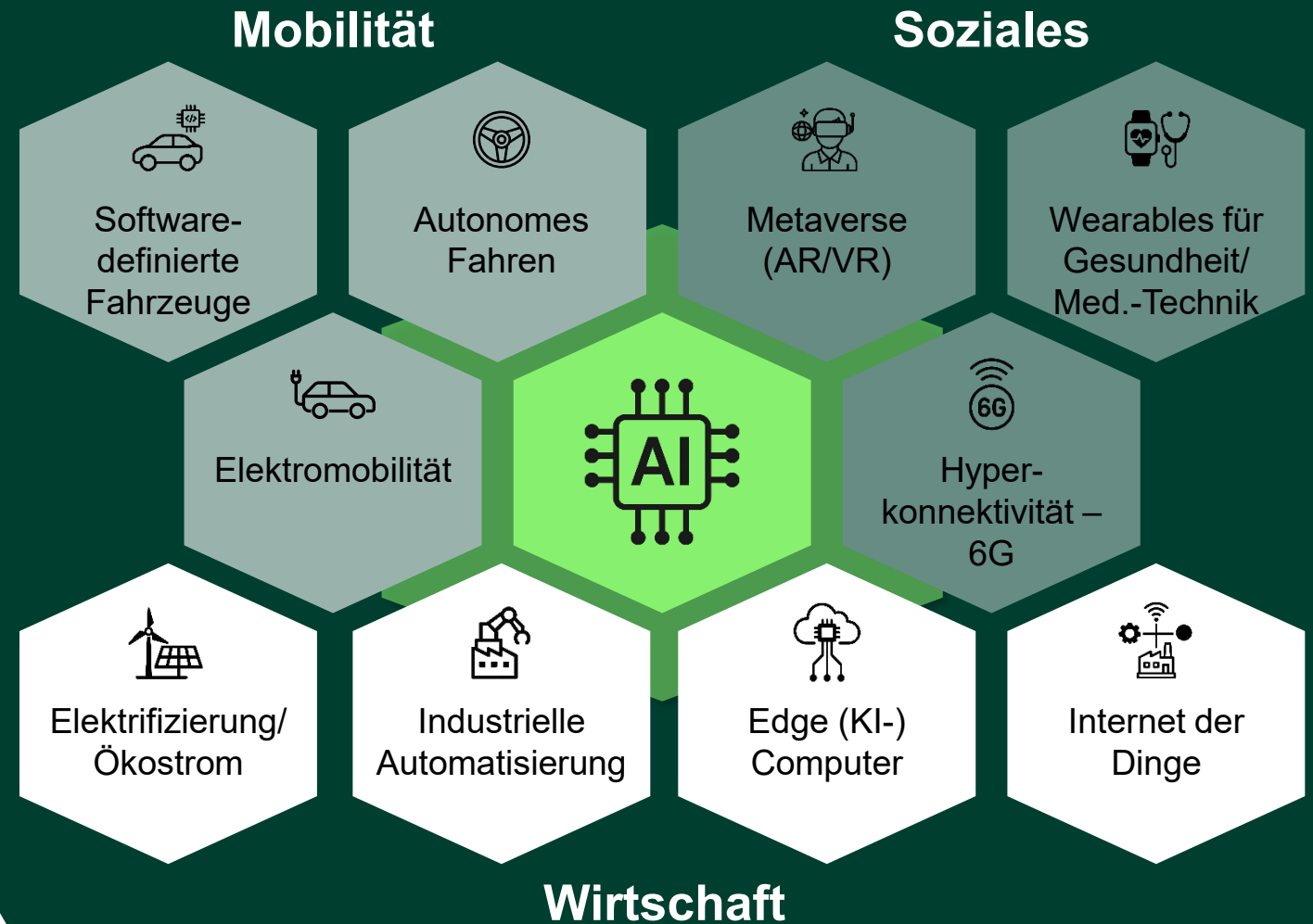
Marktüberblick





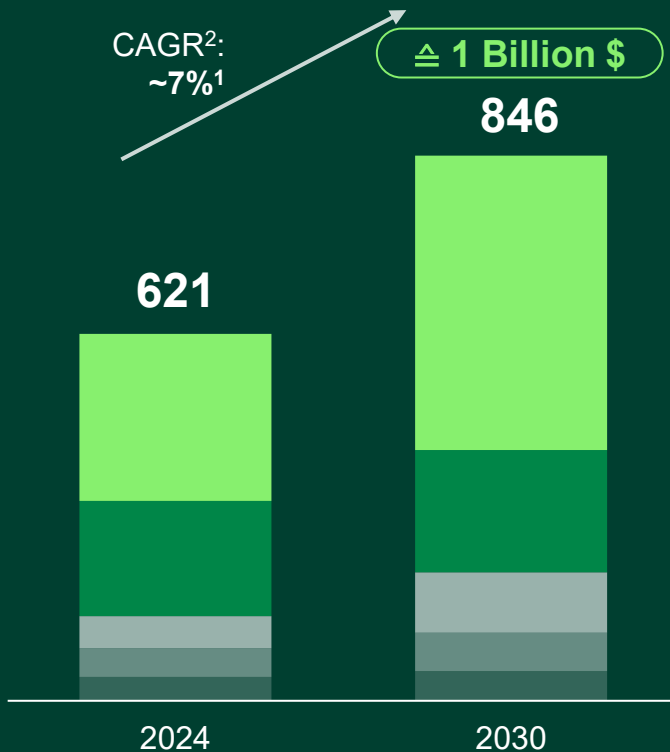
**Technologietrends,
beschleunigt durch KI,
basieren auf Halbleitern**
und treiben das schnelle Wachstum
im Halbleiter-Ökosystem voran












Trendauswahl – nicht vollständig



KI-gestützte, langfristige Trends treiben die Halbleiterbranche bis zu einer Marktgröße von 1 Billion US-Dollar im Jahr 2030 voran

Prognose für den Umsatz mit Halbleitern (in Mrd. €) & Treiber



Marktsegment	Wachstumstreiber
Computer & Daten-speicherung	<div>  KI (Generative-, Agentic-, Physical-AI) </div> <div>  Autonomes Fahren </div> <div>  Industrielle Automatisierung / Internet der Dinge </div> <div>  Metaverse (AR/VR) </div>
Kommunikation	<div>  Hyperkonnektivität – 6G </div>
Automobil-industrie	<div>  Softwaredefinierte Fahrzeuge / Autonom. Fahren </div> <div>  Elektrifizierung der Automobilindustrie </div>
Industrie	<div>  Industrielle Automatisierung / Internet der Dinge </div> <div>  Elektrifizierung / Öko-Stromerzeugung </div>
Konsumenten-märkte	<div>  Metaverse (AR/VR) </div> <div>  Wearables für das Gesundheitswesen </div>

¹ Basierend auf US-Dollar-Werten; ² CAGR = Compound Annual Growth Rate = durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
 Quellen: SUSS Recherche; Marktgröße basierend auf Yole (2025); Hinweis: USD/EUR Wechselkurs-Kalkulationsbasis = 1.18, USD/EUR 2024 Wechselkurs = 1.08

Steigende Anforderungen verwischen die Grenzen zwischen Frontend und Backend, was in unserer Business Unit-Strategie verankert ist

Frontend

Reduzierung der Technologieknoten: Moore's Law setzt sich fort, wobei die Knoten in Richtung Ängström-Ära schrumpfen

Effiziente und umweltfreundliche Prozesse:

Steigende Kundennachfrage nach reduziertem Materialverbrauch und umweltfreundlichen Materialien

Backend

Advanced Packaging: Entwicklung und breite Einführung heterogener Chiplet-Technologie

Höhere Genauigkeit und Sauberkeit führen Kundenanforderungen näher an Frontend-Standards heran

Photomask Solutions

Photomask Cleaning, Bake & Develop

Wafer Cleaning

Advanced Backend Solutions

Bonding, Coating & Imaging

2.5/3D Chiplet Technologie | SUSS ist gut positioniert, um von der hohen Dynamik im Bereich der 2.5D- und 3D-Entwicklung zu profitieren

Temporary Bonding

- **HBM:** Strukturelle Unterstützung beim Dünnen

Hybrid Bonding

- **HBM:** Stapeln der DRAMs¹
- **CPO:** Stapeln der PIC & EIC¹
- **SoIC:** E.g., Logic-on-Logic¹

Inkjet-/ Spin Coating

- **TIV:** Lithografie
- **RDL:** Lithografie¹

UV-Scanner (Exposure)

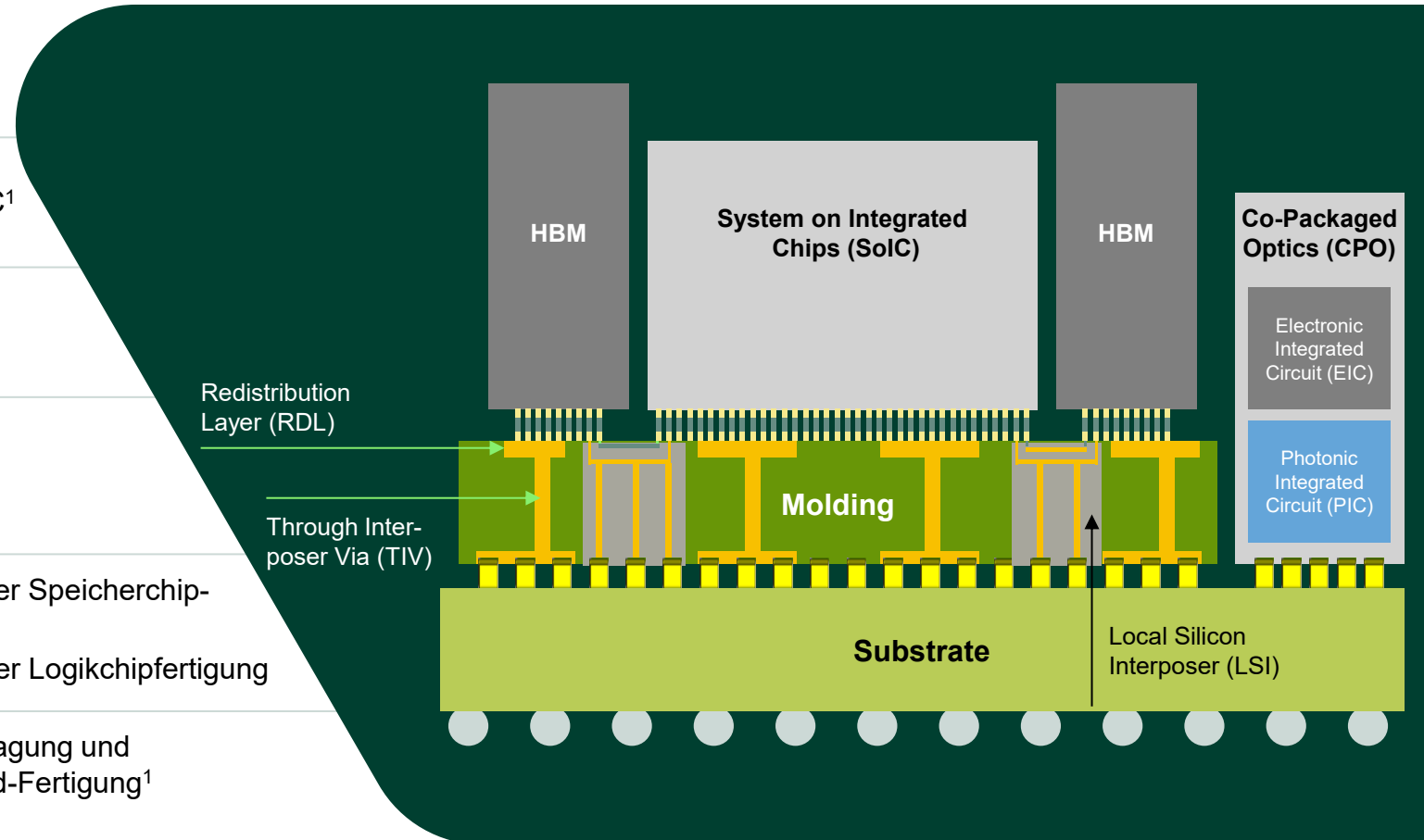
- **TIV:** Lithografie
- **RDL:** Lithografie¹

Photomask Cleaning (Frontend)

- **HBM:** Maskenreinigung in der Speicherchip-Fertigung
- **SoIC:** Maskenreinigung in der Logikchipfertigung

Wafer Cleaning

- **HBM:** Kritische Materialabtragung und Endreinigung in der Backend-Fertigung¹



¹ Mögliche zukünftige Anwendungsfälle

● BU Advanced Backend Solutions

● BU Photomask Solutions

Effiziente & grüne Prozesse | Nachfrage nach ESG-konformen Anlagen steigt

Null-Emissionswachstum bis 2025, und Erreichen der Netto-Null-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2050.

TSMC **minimiert** kontinuierlich den **Ressourcenverbrauch an der Quelle**, passt die Parameter für den Rohstoffverbrauch und technische Lösungen für Prozessverbesserungen an und kollaboriert mit Lieferanten zur Materialoptimierung und -minimierung



Absolute Reduzierung der betrieblichen Emissionen um 42 % bis 2030 (ggü. 2020) und Netto-Null-Emissionen bis 2050.



Amkor verpflichtet sich, die absoluten **Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) bis 2033 um 55 % gegenüber 2022 zu senken**.

Netto-Null-CO2-Emissionen entlang der Wertschöpfungskette bis 2050.



Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Produkten (Cradle to Grave)



Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden, um den CO2-Fußabdruck über alle Lebenszyklusphasen hinweg zu reduzieren.

Materialsparende Prozesse



Wir haben Verfahren/Anlagen entwickelt und entwickeln diese weiter, um den Einsatz schädlicher Materialien zu reduzieren.– z.B.

- **Inkjet** spart >50% Coating-Material,
- **Pellicle Glue Buster** reduziert den Verbrauch von Säuren um bis zu 1.000 mal (Maskenreinigung)

Verwendung umweltfreundlicher Materialien



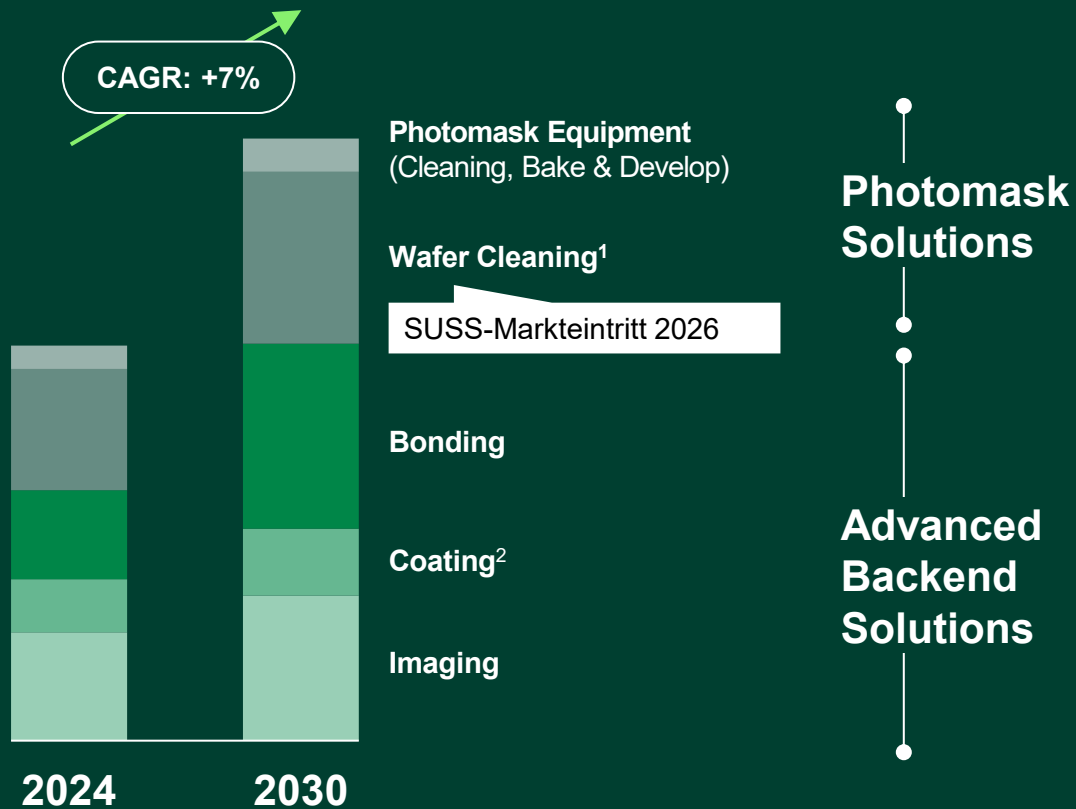
Wir haben Verfahren/Anlagen entwickelt und entwickeln diese weiter, um schädliche Materialien zu ersetzen – z.B. bei der Waferreinigung.

- **Ersatz schädlicher Lösungsmittel auf Erdölbasis** durch innovative Flüssigkeiten auf Wasserbasis
- **Zersetzung organischer Stoffe durch UV-Licht** – Keine schädlichen Rückstände bleiben zurück

Quellen: Unternehmenswebseite und Jahresberichte

Bedienbarer Markt wird bis 2030 voraussichtlich um ~7 % p.a. wachsen

Bedienbarer, verfügbarer Markt (Umsatz in Mio. €)



¹ MEMS, Power, CMOS Image Sensors & Advanced Packaging Markt berücksichtigt; ² Nur Backend-Coating-Markt; Inkjet: Potenzial durch Expansion in additive Fertigung nicht berücksichtigt | Quelle: SUSS Recherche, insbesondere basierend auf Yole



Photomask Equipment

- **Wachstum im High-End-Markt f. Maskenreinigung**
- Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum (in % p.a.) im Markt für Mid-End-Maskenreinigung



Wafer Cleaning

- **Markteinstieg mit MEMS, Power & CMOS Image Sensors;** Expansion ins Advanced Packaging mit 300 mm-Tool geplant (Tool-Launch im Jahr 2027)
- Speicherchips – Zukunftspotenzial (in Marktgröße unberücksichtigt)



Bonding

- **Temporäres Bonding wird weiter wachsen,** vor allem aufgrund der hohen KI-Nachfrage
- **Hybrid Bonding mit großem Wachstumspotenzial,** getrieben durch Logik-/Speicherchips



Coating

- **Advanced Packaging treibt Wachstum** im Backend-Coating voran
- **Inkjet bietet Potenzial außerhalb des klassischen Coatings,** Eintritt in die additive Fertigung



Imaging

- **Advanced Packaging sorgt für Wachstum;** größere Chips/Packages unterstützen Adaption von (Full Field) Projektionsscannern

Ambition 2030



Unsere neuen langfristigen Ambitionen bis 2030

€ 750 – 900 m

Umsatz
SUSS Ambition 2030

20 – 22%

EBIT-Marge
SUSS Ambition 2030

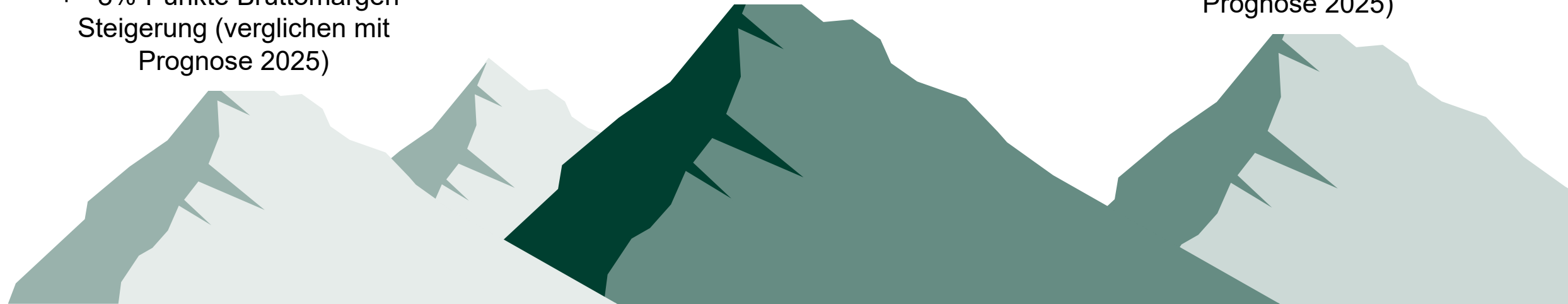
43 – 45%

Bruttomarge
SUSS Ambition 2030

~ 9 –13% Umsatzwachstum
p.a. (verglichen mit
Prognose 2025)

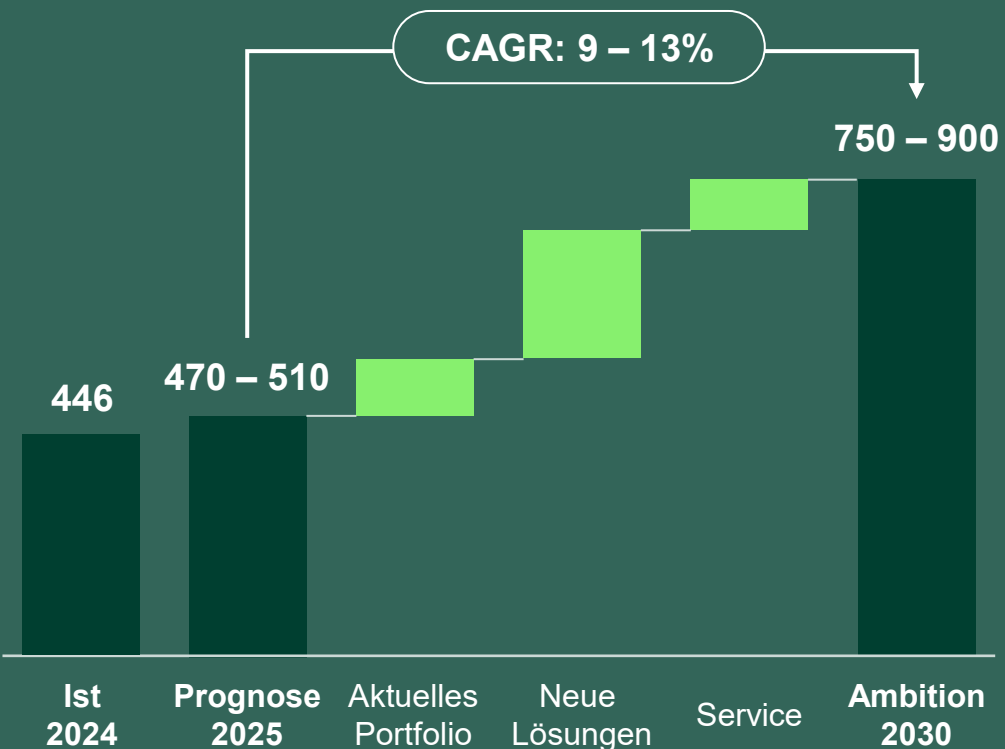
+ ~9%- Punkte EBIT-Margen-
Steigerung (verglichen mit
Prognose 2025)

+ ~8%-Punkte Bruttomargen-
Steigerung (verglichen mit
Prognose 2025)



Wachstum auf Basis eines sich stark entwickelnden Portfolios, neuer Lösungen und eines gestärkten Service-Geschäfts

Umsatzentwicklung (in Mio. €)



Aktuelles Portfolio – Hauptwachstumstreiber:

- Photomask Equipment** #1 im High-End-Segment bleiben und führende Marktposition auf Mid-End-Bereich ausweiten
- Temporary Bonding** Führungsrolle behaupten – insbesondere im Bereich HBM
- UV-Scanner** Erweiterung der Präsenz im Advanced Packaging, #1-Position bei führender Foundry als Hebel nutzen

Neue Lösungen – Hauptwachstumstreiber:

- Wafer Cleaning** Markt für Wafer Cleaning mit innovativer, kosten-effizienter und nachhaltiger Lösung betreten
- Hybrid Bonding** Eintritt in den Advanced Logic and HBM-Markt, unterstützt durch exzellenter Technologie
- Inkjet Coating** Inkjet-Markt ebnen – mit smarten Lösungen für Coating und für die additive Fertigung

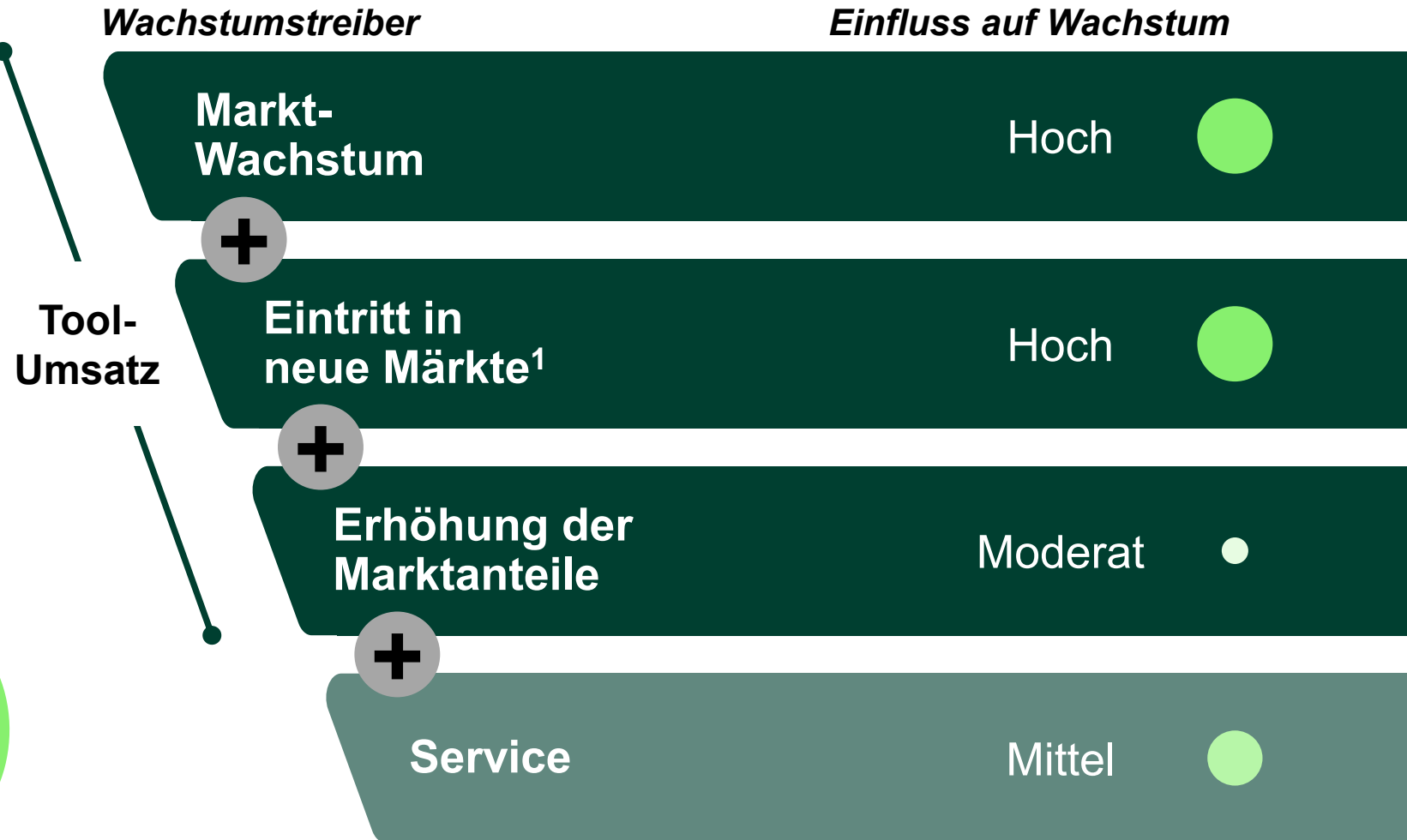
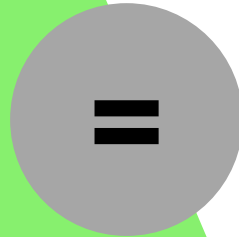
Service – Hauptwachstumstreiber:

Umsatzanteil von 18 auf 25 % steigern, indem Service zu einem strategischen Treiber für die Geschäftsentwicklung wird

Wachstumskurs gestützt durch KI-getriebenen Marktaufschwung und kontinuierliche Expansion in neue Segmente

 **SUSS**
2025 - 2030

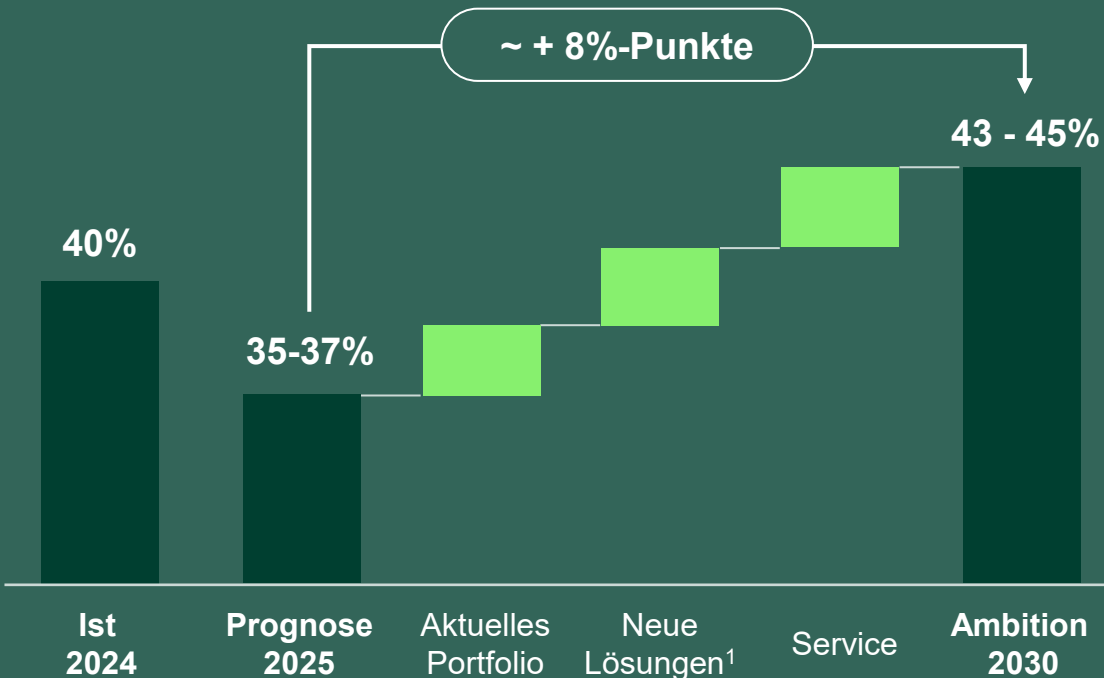
9 – 13%
Umsatzwachstum
pro Jahr



1) Wafer Cleaning & Hybrid Bonding

Ausgewogene Margenverbesserung durch das bestehende Portfolio, durch neue Lösungen und durch das Service-Geschäft

Entwicklung der Bruttomarge (in %)



1) Wafer Cleaning, Hybrid Bonding & Inkjet

Aktuelles (und sich weiterentwickelndes) Portfolio:

- Neue, modulare und standardisierte Produktgenerationen (z.B. neuer Mask Cleaner, UV-Scanner und Mask Aligner)
- Optimiertes Produktionsnetzwerk und weiter verbesserte Kapazitätsauslastung

Neue Lösungen:

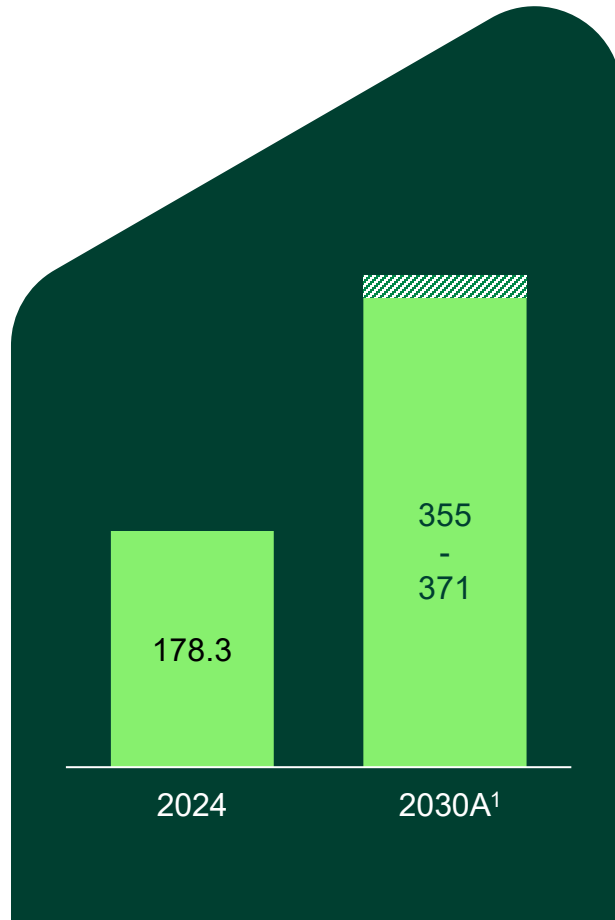
Neue Produkte mit höheren Margen (verglichen mit dem aktuellen Portfolio) aufgrund eines neuen Anlagendesigns (Ausnahme: Hybrid-Bonder, bei dem das Die-Bonding-Modul extern bezogen wird)

Service:

Verbesserung der Marge durch strategischeres Management der installierten Basis und fokussiertes Service-Produktportfolio

EBIT-Marge profitiert von einem höheren Geschäftsvolumen – gleichzeitig steigende F&E-Ausgaben und sinkende Vertriebs- und Verwaltungskosten erwartet

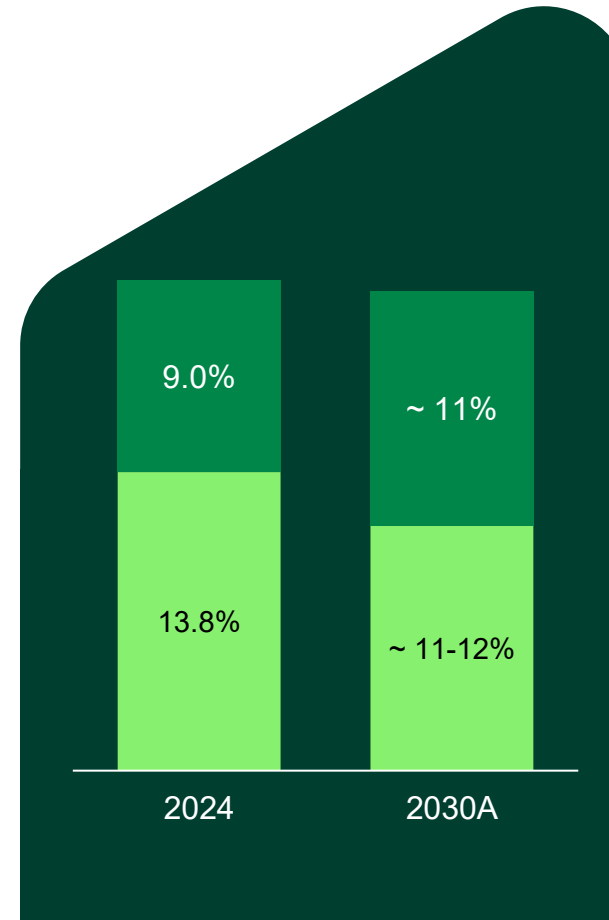
So wollen wir die angestrebte EBIT-Marge von 20 bis 22 % erreichen



Steigerung des Bruttoergebnisses vom Umsatz

Das **Bruttoergebnis vom Umsatz** könnte sich von 2024 bis 2030 verdoppeln, unterstützt durch ein größeres Geschäftsvolumen mit verbesserter Profitabilität.

¹ Berechnungsgrundlage: Mittelwert des für 2030 angestrebten Umsatzes



Reduzierte Vertriebs- und Verwaltungskostenquote prognostiziert

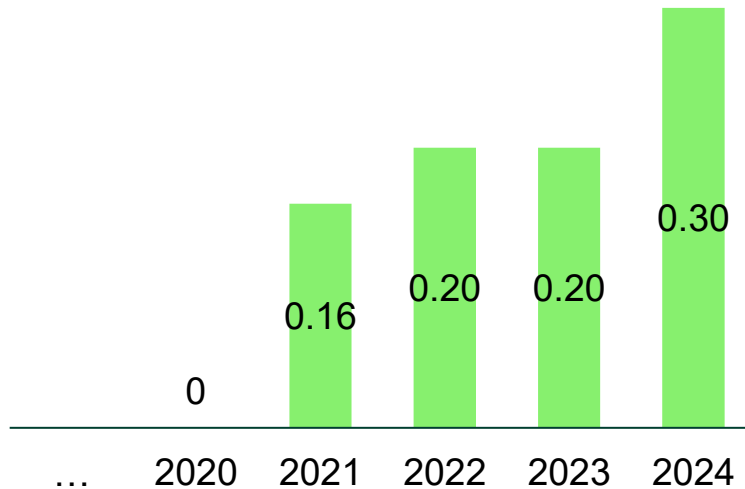
- **R&D-Ausgabenquote** soll steigen, um das Umsatzwachstum zu unterstützen
- **Vertriebs- und Verwaltungskostenquote** soll sich um ~ 2 bis 3 %-Punkte reduzieren, indem die Aufwendungen langsamer steigen als der Umsatz

■ F&E-Ausgabenquote
■ Vertriebs- und Verwaltungskostenquote

Wir haben für die Jahre 2021 bis 2024 Dividenden in Höhe von 16,4 Millionen Euro ausgeschüttet

Dividendenausschüttung 2021 – 2024

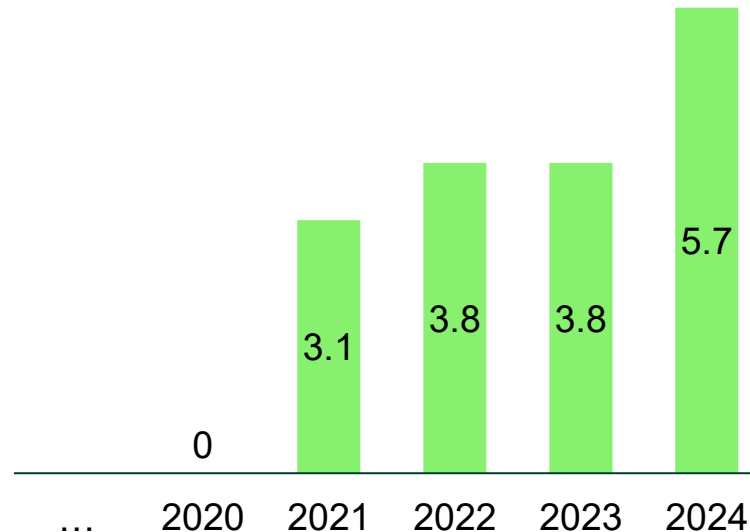
(in € je Aktie; Auszahlung im Folgejahr)



SUSS hat im März 2022 die erste Dividendenpolitik verabschiedet; erste Ausschüttung somit für das GJ 2021.

Dividenenauszahlung gesamt 2021 – 2024

(in Mio. €; Auszahlung im Folgejahr)



Die Gesamtdividendenzahlungen für die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 beliefen sich auf 16,4 Millionen Euro.



Dividendenpolitik

- Unsere Aktionäre sollen durch zuverlässige und angemessene Ausschüttungen am Erfolg des Unternehmens teilhaben.
- Gleichzeitig soll das Unternehmen über ausreichende Finanzmittel für das operative Geschäft und strategische Investitionen verfügen und eine angemessene Eigenkapitalquote aufrechterhalten.
- Dividendenrichtwert: 20 bis 40 % des konsolidierten Free Cashflows

Unser Ziel ist es, SUSS bis 2030 auf ein neues finanzielles Niveau zu führen.

	GJ 2024	GJ 2030A
Umsatz	446,1 Mio. €	750 - 900 Mio. €
Umsatzwachstum	46,6% (ggü. 2023)	9 - 13% (CAGR 2025 – 2030A ¹)
Bruttomarge (in %)	40%	43 - 45%
Vertriebs-/Verwaltungskosten	13,8% (vom Umsatz)	~11 - 12% (vom Umsatz)
F&E-Aufwendungen	9%	~11%
EBIT-Marge (in %)	16,8%	20 - 22%
Free Cashflow	25,3 Mio. €	~ 90 Mio. €
ROCE	36,8%	39 - 41%
Investitionen	7,6 Mio. €	~ 22 Mio. € (Durchschnitt p.a. 2026 – 2030)
Steuerquote	33,1%	~28% ²

¹ Durchschnittliches jährliches Wachstum ist berechnet auf Basis von 490 Mio. € im Jahr 2025; ² Die interne Planungsannahme für den Steuersatz beträgt in der Regel ~ 28 %.



Zeit für Ihre Fragen

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Ergebnisse der SUSS MicroTec SE und ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Plänen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die größtenteils schwer einzuschätzen sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der SUSS MicroTec SE liegen. Folglich können die tatsächlichen Entwicklungen sowie die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommenen abweichen.

Die SUSS MicroTec SE beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen.

Vielen Dank

Growing Innovation



Sven Köpsel

VP Investor Relations & Communications

Tel.: +49 89 32007-151

E-Mail: sven.koepsel@suss.com



Florian Mangold

Manager Investor Relations

Tel.: +49 89 32007-306

E-Mail: florian.mangold@suss.com